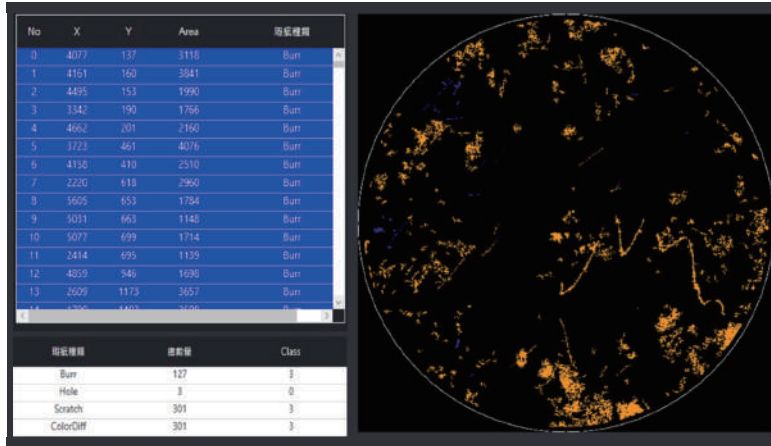


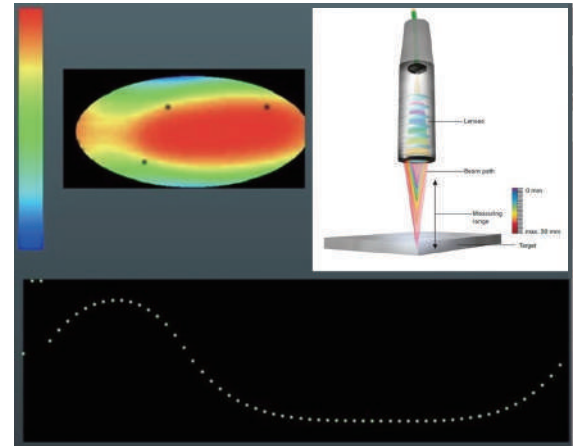
智能光學晶圓 / 晶片表面瑕疵與高度變化檢測系統

SE-5AT2-100 優勢與特色

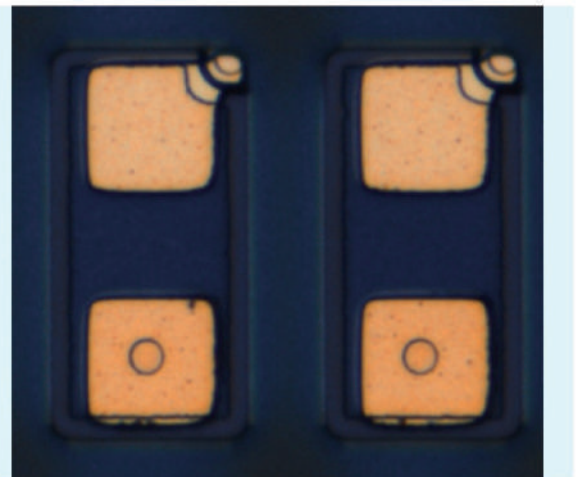
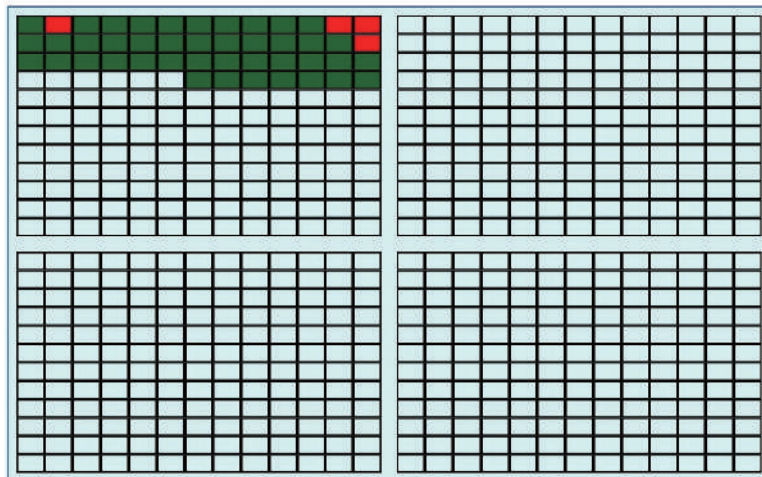
- 針對半導體晶圓於製程中所產生的缺陷提供精準光學檢測分析，利用自動對焦之顯微鏡模組搭配三軸位移平台進行飛拍。
- 可依需要檢出的瑕疵提供影像比對方法與 AI 影像深度學習法兩種，降低過檢 (Over kill) 及漏檢 (Under kill) 的發生。
- 可自訂公差自動分選 OK、NG件，針對瑕疵計算面積大小、瑕疵數量及瑕疵位置標註，亦可整合自動化，提高檢測效率。



AI判定結果，晶圓上的瑕疵種類、座標、面積、數量
清楚明瞭，數據完善整合



透過白光共軛焦模組掃描
取得晶圓全片厚度變化



晶片mapping瑕疵檢測畫面



名稱	SE-5AT2-100
瑕疵量測項目	孔洞、毛邊、色差、異物沾黏、髒污、龜裂、刮傷…等外觀缺陷。
瑕疵檢測精度(光學解析度)	±1μm
白光共軛焦量測項目	THK / TTV / WARP / BOW
白光共軛焦重複精度	±1μm
位移平台重複精度	≤±3μm
待測平台	2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 吋陶瓷真空吸附檯面
機台尺寸	1200L*1000W*1779H (mm)
電源規格	單相110V / 60Hz / 2200W
氣源規格	6-7 Kgf/cm ²
資料數據化 / 雲端化	量測結果數據可輸出報表，並可與API對接，將量測結果數據拋轉至客戶內部系統整合。